

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成23年11月24日(2011.11.24)

【公開番号】特開2009-137002(P2009-137002A)

【公開日】平成21年6月25日(2009.6.25)

【年通号数】公開・登録公報2009-025

【出願番号】特願2008-266367(P2008-266367)

【国際特許分類】

B 8 1 C 3/00 (2006.01)

H 0 1 L 23/02 (2006.01)

H 0 1 L 23/10 (2006.01)

B 8 1 B 1/00 (2006.01)

【F I】

B 8 1 C 3/00

H 0 1 L 23/02 B

H 0 1 L 23/10 B

B 8 1 B 1/00

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月11日(2011.10.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

それ自体に対して閉じられる、周辺のシール・ストリップ(3)を圧壊することによって互いに接合される2つの対向する基板(1、4)を備える構造体を製造する方法であって、

前記シール・ストリップ(3)は、前記基板(1、4)の間に閉空洞を画定し、

前記シール・ストリップ(3)は、圧壊前に、複数のボイドを前記ストリップ(3)内に画定する連続した穿孔パターン(5)を含み、

前記穿孔パターン(5)が、ボイドによって前記基板(1、4)に垂直に穿孔されたバーにより形成される、ことを特徴とする方法。

【請求項2】

前記基板に平行な平面において、前記シール・ストリップ(3)の前記ボイドの表面と、前記ストリップの合計表面との間の比率が、10%~50%の間に含まれることを特徴とする、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記ボイド(6)は前記基板(1、4)に垂直な円筒形であることを特徴とする、請求項1および2のいずれか一項に記載の方法。

【請求項4】

前記ボイド(7)は、前記ストリップの側面に垂直であり、前記基板(1、4)に平行であることを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。

【請求項5】

2つの隣接するボイド間の縁部間隔(P)と前記ボイドの最小横寸法との間の比率が1未満であることを特徴とする、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

2つの隣接するボイド間の縁部間隔（P）と前記ボイドの最小横寸法との間の比率が0.5～0.8の間に含まれることを特徴とする、請求項5に記載の方法。

【請求項7】

前記シール・ストリップ（3）は、前記基板（1、4）の接合前に不連続であり、次いで、前記2つの基板（1、4）の密閉後に連続になることを特徴とする、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の方法。

【請求項8】

追加ストリップ（10）および/または補強部（11）を備えることを特徴とする、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の方法。

【請求項9】

光学的に透明な領域であって柱（8、9）および/または穿孔パターン（5）のボイド（6）の上方に位置する領域を含む前記基板（1、4）の一つにおいて、前記柱（11）および/または前記穿孔パターン（5）の前記ボイド（6）の寸法を、前記穿孔パターンの形成後および接合後に測定することによって圧壊の均一性が検査されることを特徴とする、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の方法。

【請求項10】

前記シール・ストリップ（3）、追加ストリップ（10）、および補強部が、同じ材料から、同じ技術的ステップ内で形成されることを特徴とする、請求項8および9のいずれか一項に記載の方法。